仕 No, IS-9194F 来歷/REV. 2 品 様 頁 1/4PRODUCT SPECIFICATION 制定年月日 4-23-04題: 9194シリーズ 2.0 mmピッチ ボード トゥ ボード コネクタ ISSUE DATE SUBJECT: SERIES 9 1 9 4 2.0 mm pitch board to board connector 改訂年月日 2-13- '13 REVISED DATA

1.Scope

3.Rating

1. 適用範囲

本仕様書は、イリソ電子工業株式会社製9194シリーズ2.0 mmピッチボード トゥボード コネクタに関する仕様及び性能上の必要事項について規定する。

2. 形状、寸法及び材質

構造、寸法、主要部品の材質、表面処理等は添付図面による。

(鉛フリーめっき品に適用する) 適合ソケット・IMSA - 0104S - 8

適合ソケット: IMSA-9194S-***-TC 適合プラグ: IMSA-6***B-**-TC

3. 定格

(1)最大定格電圧 : 125V(AC,DC)

(2)最大定格電流 : 1A

(3)使用温度範囲 : -40~+105℃

4. 試験環境

特に規定のある場合を除き性能試験は下記の環境条件にて行う。

常温 : 15~35℃ 常湿 : 25~85%RH

4.Environmental condition All performance test, un as per following environ

(3)Temperature range

All performance test, unless otherwise specified, is taken

: -40~+105°C

This product specification is applied for IRISO ELECTRONICS CO.,LTD. Series 9194 2.0 mm pitch board to board connector.

as per following environmental condition. Ambient temperature : $15\sim35^{\circ}$ C

Ambient humidity : $25\sim85^{\circ}$ RH

2. Configurations dimensions and materials

See the product drawing attached.

(Applied for Pb free plate product)

(2)Maximum rating current: 1A

Socket: IMSA-9194S-***-TC

Plug : IMSA-6***B-**-TC

(1)Maximum rating voltage: 125 V (AC,DC)

5. 特性

5-1.電気的特性

5.Performance

5-1. Electrical performances

5 1. Like tricker perior man			
No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	接触抵抗	短絡電流 1mA、最大開放電圧 20mV、周波数 1kHz のローレベル	初期値: 50mΩ以下
	Contact resistance	抵抗計にて測定する。	各試験後:100mΩ以下
		It shall be measured by the dry electric circuit specified	Initial : $50 \text{m}\Omega$ or below
		as follows; 1mA, 20mV, 1kHz frequency.	After each test: $100 \text{m} \Omega$ or below
2	耐電圧	隣接する極間にAC 250Vを1分間印加する。	絶縁破壊等異常のない事。
	Dielectric	AC 250 V shall be applied for one minute to between next	Should not have any changes.
	withstanding	terminals.	
	voltage		
3	絶縁抵抗	隣接する極間に DC 250V を印加し、測定する。	初期値:500MΩ以上
	Insulation	It shall be measured when 250V DC is applied to between next	Initial: $500M\Omega$ or more
	resistance	terminals.	耐湿試験後:100MΩ以上
			After humidity test: $100M\Omega$ or more
4	外観	目視	有害となる割れ、剥がれ、ガタ
			変形、変色等のない事。
	Appearance	Visual	Should not have any flaw, scratch,
			discoloration and crushed.

5-2.機械的特性 5-2.Functional performance

1发1次月71日	5-2. Functional performance	
項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
コンタクトの保持力	コンタクトに 25mm/分の速度で荷重を加え、コンタクトが	4.9N 以上
	ハウジングより抜け始めるまでの荷重を測定する。	4.9N or more.
Contact retention	It shall be pulled to the contact at the speed of 25mm	
force	per minute, and measured the force when the contact	
	begins to remove from the housing.	
挿抜力	ソケットとピンヘッダーを25mm/分の速度で挿抜を行ない、	初期値にて/Initial (単極にて)
	この時の荷重を測定する。	挿入力: 4.41N以下/極
Insertion/extraction	The socket and pin header shall be mated and unmated	抜去力:0.49N以上/極
force	at the speed of 25mm per minute and measured the	Insertion force: 4.41N or
	force of insertion and extraction.	below / terminal
		Extraction force: 0.49N or
		more / terminal
挿抜耐久性		100mΩ以下
		$100 \mathrm{m}\Omega$ or below
endurance	1 1	
	the contact resistance after the test.	
	項目/Items コンタクトの保持力 Contact retention force 挿抜力	項目/Items 条件/Test conditions コンタクトの保持力 コンタクトに25mm/分の速度で荷重を加え、コンタクトがハウジングより抜け始めるまでの荷重を測定する。 Contact retention force It shall be pulled to the contact at the speed of 25mm per minute, and measured the force when the contact begins to remove from the housing. 「特抜力 ソケットとピンヘッダーを25mm/分の速度で挿抜を行ない、この時の荷重を測定する。 Insertion/extraction force The socket and pin header shall be mated and unmated at the speed of 25mm per minute and measured the force of insertion and extraction. 「特抜耐久性 ソケットとピンヘッダーを25mm/分の速度で30回繰り返し挿抜を行ない、試験後の接触抵抗を測定する。 Insertion/extraction The socket and pin header shall be mated and unmated

				T	
No.	IS-9194F	来歷/REV.	2	頁/Page	2/4

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
4	振動試験 Vibration test	コネクタを嵌合した状態にて、振幅 1.5 mm, 振動周波数 10~55~10Hz 毎分の条件で嵌合軸を含むお互いに直角な 3 方向に各々 2 時間 計 6 時間 の振動を加える。試験中瞬断の 有無を確認する。試験後接触抵抗を測定する。	試験中 1μs 以上の瞬断のない事。 試験後: 100mΩ以下
		The connector mated is vibrated in the frequency range of $10\sim55\sim10$ Hz per minute and in the constant vibration amplitude 1.5 mm. This motion is applied for period of 6 hours in one of 3 multilateral perpendicular directions (X,Y,Z-axis) included mating axis. It shall be tested the discontinuity of the contact current during the test and measured the contact resistance after the test.	Discontinuity : $1\mu s$ or below After the test : $100 m\Omega$ or below
5	衝撃試験	コネクタを嵌合した状態にて、治具に取付け、加速度 490m/s ² 、衝撃作用時間11ms を X,Y,Z 方向の 6面に各3回加える。試験中瞬断の有無の確認及び、試験後 接触抵抗を測定する。	試験中1μs 以上の瞬断の無いこと 試験後:100mΩ以下
	Shock test	The connector mated are installed in the machine. They are applied pulses 3 times to each 6 faces of 3 multilateral perpendicular directions(X,Y,Z); in conditions as specified; acceleration of 490m/s² and shock pulses for a duration of 11ms. It shall be tested the discontinuity of the contact current during the test and measured the contact resistance after the test.	Discontinuity : $1\mu s$ or below After the test : $100 m\Omega$ or below

<u>5-3.環境特性</u> <u>5-3.Environmental performance</u>

	. 块块行性	5-3.Environmental performance		
No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications	
1	耐熱性	コネクタを嵌合した状態にて、温度 105±2℃の雰囲気中に 96 時間放置し、 放置後接触抵抗を測定する。	100mΩ以下	
	Heat resistance	The connector mated is exposed in the heat chamber 105±2°C for	$100 \mathrm{m}\Omega$ or below	
		96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	TOOTIES OF BOILDW	
2	耐湿性	コネクタを嵌合した状態にて、温度 60±2℃、相対湿度 90~95%RH の	100mΩ以下	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	雰囲気中に96時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。	20011120()	
	Humidity	The connector mated is exposed in the humidity chamber $60\pm2^{\circ}$ C.	$100 \mathrm{m}\Omega$ or below	
		90~95%RH for 96 hours. It shall be measured the contact		
		resistance after the test.		
3	塩水噴霧試験	コネクタを嵌合した状態にて、槽内温度 35±2℃、濃度 5±1%の塩水	100mΩ以下	
		噴霧中に48時間放置し、放置後水洗、乾燥し接触抵抗を測定する。		
	Salt spray test	The connector mated is exposed in the salt spray chamber	$100 \mathrm{m}\Omega$ or below	
		35 ± 2 °C, 5 ± 1 % salt density for 48 hours. It shall be measured		
	10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	the contact resistance after the test.	_	
4	S〇2ガス試験	コネクタを嵌合した状態にて、温度 40±2℃、相対湿度 75%、濃度	100mΩ以下	
	0.0	10±3ppm.の雰囲気中に96時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。	100 0 1 1	
	SO ₂ gas test	The connector mated is exposed in the SO ₂ gas chamber $40\pm2^{\circ}$ C,	$100 \mathrm{m}\Omega$ or below	
		75%RH 10±3ppm for 96 hours. It shall be measured the contact		
5	H ₂ Sガス試験	resistance after the test. コネクタを嵌合した状態にて、温度 40±2℃,相対湿度 75%、濃度	100mΩ以下	
) b	口20 八 八武際	3 ± 1ppm の雰囲気中に96 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。	100III 22 L	
	H ₂ S gas test	The connector mated is exposed in the H ₂ S gas chamber 40 ± 2 °C,	$100 \mathrm{m}\Omega$ or below	
	1120 gus wsi	75%RH 3±1ppm for 96 hours. It shall be measured the contact	10011132 Of Delow	
		resistance after the test.		
6	冷熱衝撃試験	コネクタを嵌合した状態にて下図の温度条件を1サイクルとして 10 サイクル実施	100mΩ以下	
	11-71(11-4-4-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-	し、試験後接触抵抗を測定する。		
	Thermal	The connector mated is exposed 10 cycles in the following	$100 \mathrm{m}\Omega$ or below	
	shock test	temperature. It shall be measured the contact resistance after		
		the test.		
Ì		+85± 2 ℃		
		30min		
		Ambient 常温 temperature		
		常温 temperature 30min		
		SOUTH		
		-55±3℃		
		1cycle		
L		,		

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
7	温湿度サイクル試験	コネクタを嵌合した状態で下図の温湿度条件を1サイクルとして	100mΩ以下
		10 サイクル実施し、試験後接触抵抗を測定する。	
	Humidity Resistance	The connector mated is exposed 10 cycles in the following conditions. It shall be measured the contact resistance after	$100 \mathrm{m}\Omega$ or below
	(cycling)	the test.	
	(-3/2/		
		+80±2°C	
		90~95%RH	
		-20±3℃	
		← 2h > ← 2h > ← 2h >	
		1 cycle	

5-4.その他の特性

5-4.Other performance

	C 071607101T	5-4.Other performance	
No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	半田付け性	コネクタの半田付け部をフラックスに浸漬した後、245±5℃の	浸した面積の 95%以上に半田が むらなく
		Sn-Ag-Cu 系の鉛フリー槽に 3±0.5 秒浸す。	付着する事。
	Solderability	The terminal of connector shall be put into the flux and dipped	Solder shall be covered 95% or more of the
		into Pb free solder bath(Type of Sn-Ag-Cu) 245 ± 5 °C、 3 ± 0.5 s.	area that is dipped into the solder bath.
2	半田耐熱性	下記条件にて、半田耐熱試験を行う。	端子のガタ、割れ等異常のない事。
	Resistance to	The connector shall be tested resistance to soldering heat in	Should not have any flaw, scratch and
	soldering heat	the following conditions.	crack.
		(1)リフローの場合/In case of reflow	
		2 <u>50℃MAX(ピ-ケ温度)</u>	
		(Peak temperature)	
		*	
		(30s) 200°CMIN.	
		(予熱 150~180℃)	
		(pre-heat : from 150 to 180°C)	
		温度は基板バターン面の温度とする。	
		The temperature shall be measured on the surface of the PCB.	
		(2)手半田 の場合/ In case of manual soldering.	
		半田鏝温度 / temperature :350±5℃	
		浸漬時間 / time : 3±0.5s	
		基板厚/thickness : t=1.6 mm	
		(3)ディップの場合 / In case of dip.	
		半田槽温度 / temperature :260±5℃	
		時 間 / time : 5±0.5s	
		基板厚/thickness : t=1.6 mm	

6.ウィスカーに関して

本製品は、錫系のめっきを施しておりますので、ウィスカーが発生する可能性がございます。その為、ウィスカー発生に対する保証は困難であり、御社にて御判断の上御使用をお願いします。

7.和文と英文の差異について 🛕

和文と英文の内容に差異が生じた場合には、和文の内容を優先致します。

6. About a whisker

This product utilizes lead-free tin plating. Any product with lead-free tin plating is susceptible to tin whisker. Iriso provides no assurances against the growth of tin whisker even under normal operating conditions. Customers assume all responsibility for any product failures due solely to the growth of tin whiskers.

7. Difference between Japanese and English

When difference is found between Japanese specifications and English specifications, priority shall be given to Japanese.

No. IS-9194F 来歷/REV. 4/42 頁/Page

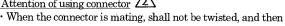
8. 使用上の注意 /2

- ・斜め嵌合やこじる事の無い様にゆっくりと挿抜して下さい。
- ・角度を付けた状態で押し込むとモールド端面どうしが強く擦れる事に より、削りカスが発生します。
- ・位置決め後、モールド両端がゆるく嵌まった事を確認して真っ直ぐ押 し込んで下さい。
- ・抜去時は真っ直ぐ抜いて下さい。コネクタの片側だけが持ち上がる様 な回転抜去を行いますとモールドが破損する可能性があります。
- 下記のモデル形状は参考とします。(現物と異なる場合があります)
- ・コネクタのみで基板の固定は行なわないで下さい。使用の際、コネク 夕の実装位置に近い位置で、必ず基板をビスにて確実に固定して下さ い。コネクタに掛かる加速度は、セット組立品に於いても 43.12m/s² 以下とする事。(共振振動が加わらない事。)
- ・誘い込み時の角度は図2~図3になりますので、記載角度以下で位置 決めをして下さい。

(誘い込み時の角度とは最初の位置決め角度であり、嵌合可能な角度で はありません。)

8. Attention of using connector

mated it slowly.

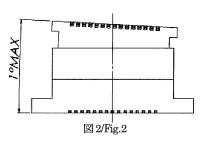


- The angled mating, occurs shavings.
- · After positioning, please check that mold both ends have fitted in loosely, and push in straight.
- · Please be pulled out straight. Pulling on one side, the mold is broken.
- · It refers to the model shape of the reference of the following. (It differs from a actual connector.)
- · It shall not be held the connector only, when you are assembled for the connector and P.C.B.
- · When it shall be used the connecter, the P.C.B. are held by the rivet certainty near mounting of the connector. Acceleration of connector: 43.12m/s2 or less.

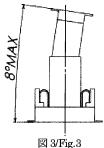
(The connector shall not be added to be added to resonance acceleration.)

· Figure 2 and 3 show guiding angle. Please locate it below the described angle.

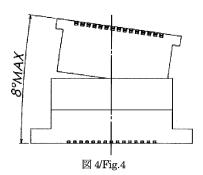
(Guiding angle is initial location angle. It is not the angle to mate.)



誘い込み時の角度 Guiding angle



・嵌合時の許容角度は図4~図5になりますので、記載角度以下で使用し ・Please mate below the angle of the figure 4,5. て下さい。



嵌合角度 Mating angle

